

農業部高雄區農業改良場
研究成果技術移轉意願書

廠商名稱	
移轉技術名稱	附掛式雷射整平器製造及裝配技術
科技計畫名稱	開發附掛式田間雷射整平機械
計畫主持人	潘光月
擬利用技術內容	田間整地作業之相關機構與技術
授權地區	我國管轄區域內，產品銷售出口地區不限
預期應用範圍及 預期產品	1. 預期應用範圍：田間整地作業 2. 預期產品：附掛式雷射整平器

申請人（公司代表人）：_____（簽章）

申請日期：_____年_____月_____日